

公司代码：688689

公司简称：银河微电

转债代码：118011

转债简称：银微转债

## 常州银河世纪微电子股份有限公司

### 2025年年度报告摘要



## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、 重大风险提示

详情敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为128,903,899股，扣减回购专用证券账户中股份总数839,384股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利32,016,128.75元（含税），占2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的40.07%。2025年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### 母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

### 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	银河微电	688689	不适用

#### 1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李福承	岳欣莹
联系地址	常州市新北区长江北路19号	常州市新北区长江北路19号
电话	0519-68859335	0519-68859335
传真	0519-85120202	0519-85120202
电子信箱	gmesec@gmesemi.cn	gmesec@gmesemi.cn

## 2、报告期公司主要业务简介

### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务

公司系专注于半导体分立器件研发、生产与销售的高新技术企业，致力于成为半导体分立器件细分领域的专业供应商及电子器件封测行业的优质制造商。公司持续深化 IDM（一体化）经营模式，以客户实际应用需求为核心导向，依托封装测试核心技术优势，进一步完善芯片设计、芯片制造、半导体器件应用技术的全链条布局，一体化经营效能得到显著提升，可高效为客户提供适用性强、可靠性高的系列化产品及定制化技术解决方案，全面满足客户一站式采购需求；同时，面向高端芯片设计公司的定制化封测代工业务规模稳步扩容，服务品质与专业能力持续升级。

#### 2、主要产品或服务情况

公司主营业务涵盖各类半导体元器件，具体包括：小信号器件（小信号二极管、小信号三极管、小信号 MOSFET）、功率器件（功率二极管、功率三极管、功率 MOSFET、IGBT、桥式整流器），同时重点推进车用 LED 灯珠、光电耦合器等光电器件、电源管理 IC 及第三代半导体（SiC、GaN）器件的产业化落地进程。2025 年公司核心产品结构持续优化，第三代半导体 SiC 器件实现关键技术突破与产能规模化提升，车规级功率器件品类进一步丰富完善，产品广泛应用于新能源汽车、工业控制、计算机及周边设备、网络通信、家用电器、适配器及电源、储能等多个核心领域，定制加工服务的响应效率与服务质量显著提升，获得下游客户的广泛认可与高度评价。

## 2.2 主要经营模式

公司始终坚持以客户需求为导向，依托强大的技术研发实力与严格的质量管控体系，持续深化多门类系列化器件设计、芯片设计、自主生产与委外流片代工相结合的晶圆制造、多工艺平台封测生产及销售服务一体化整合（IDM）模式，优化规模生产与柔性定制相结合的生产组织方式，坚守自主品牌产品直销为主的核心策略，同步提升经销渠道的覆盖广度与服务效率，为客户提供更具针对性、更贴合实际需求的产品及配套服务，实现企业与客户的协同共赢、共同成长。

### 1、采购模式

公司采用“集中管理、分散采购”的模式，将供应链管理的规范性和适应产销需求的采购快捷灵活性有效地结合起来，并通过计划订单拉动和安全库存管控相结合的方式，达到兼顾快速交付订单和有效管控存货风险的要求。

### 2、生产模式

公司采用“以销定产，柔性组织”的生产模式。公司依据专业工艺构建产品事业部组织生产，以实现产能的规模效应和专业化管理。同时，公司以市场为导向，努力构造并不断优化适应客户需求的多品种、多批次、定制化、快捷交付的柔性化生产组织模式。

### 3、营销模式

公司依托自主品牌和长期积累的客户资源，采用直销为主、经销为辅的营销模式，并利用丰富的产品种类和专业化的支持，为客户提供一站式采购服务。公司建有较强的营销团队和集客户要求识别、产品设计、应用服务、失效分析等为一体的技术服务团队，依托丰富的产品种类和专业化的技术支持，为客户提供一站式采购服务。

### 4、研发模式

公司坚持“自主研发、持续改善、产学研协同”的研发模式，2025年持续推动产学研合作向深度与广度延伸，深化与复旦大学等国内知名高校的战略合作，聚焦第三代半导体、车规级器件等核心领域的关键技术攻关。公司技术研发中心统一组织管理新产品研发及核心技术储备工作，涵盖需求识别、产品设计、新材料导入、芯片设计制造、器件封测、模拟试验验证、应用技术服务等各个核心环节，构建更加完善、相互支撑、持续改善的系统性创新体系，研发成果转化效率显著提升。

公司主要经营模式在2025年度未发生重大变化，后续将持续优化IDM一体化经营模式，强化供应链韧性建设，提升柔性生产能力与研发成果转化效率，充分满足下游产业及客户对产品多元化、高端化的核心需求，推动公司业务持续健康高质量发展。

## 2.3 所处行业情况

### (1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 行业的发展阶段

2025年中国半导体分立器件行业进入高质量发展的关键攻坚阶段，逐步摆脱低端同质化竞争困境，加速向中高端领域突破升级，国产替代进程持续深化推进。全球半导体市场逐步走出周期性波动，呈现稳步复苏向好态势，世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，2025年全球分立器件市场规模回升至352亿美元，同比增长11.6%；中国市场持续保持强劲发展韧性，2025年市场规模突破3600亿元，同比增长12.5%，核心增长动力来自新能源汽车、储能、5G通信、工业自动化等新兴领域的需求爆发，以及国内企业核心技术突破带来的国产替代红利，行业整体向高端化、绿色化、智能化方向加速转型。

国产化进程方面，2025年国内半导体企业持续加大研发投入与产能扩张力度，在功率器件（如MOSFET、IGBT）、第三代半导体（SiC、GaN）领域与国际巨头的技术差距进一步缩小，高端市场进

口替代步伐持续加快，其中 SiC 功率器件国产替代率较 2024 年提升 8 个百分点。尽管高端市场仍有部分产品依赖进口，但国产化替代的整体趋势已不可逆转，国内企业的市场话语权持续提升。

市场集中度方面，行业整合并购持续推进，市场格局从分散逐步向集中优化，CR3 提升至 12%、CR5 提升至 16%。头部企业通过持续加大研发投入、扩充产能规模、整合产业链资源等方式，持续提升核心竞争力；中小企业则逐步向细分特色领域聚焦，行业整体竞争力显著增强，发展质量持续提升。

技术迭代方面，2025 年 SGT、Super-Junction 等新结构 MOSFET 技术持续普及应用，第三代半导体材料（SiC、GaN）的商用化进程进一步加速，在新能源汽车、光伏逆变器、储能等核心场景的应用占比大幅提升，成为行业升级转型的核心引擎；同时，Clip、SiP 等先进封装技术的应用范围持续扩大，推动半导体器件向小型化、高功率密度、高可靠性方向发展。

## （2）行业的基本特点

①应用驱动特征显著：新能源汽车领域仍是功率器件需求的核心场景，功率器件（IGBT、SiC MOSFET）需求持续爆发，2025 年中国功率器件市场规模达 1820 亿元，占分立器件市场的 50.6%，其中新能源汽车用功率器件占比超 45%；储能、光伏逆变器领域需求快速增长，带动高压、高频功率器件需求持续提升；5G 与 AI 领域，射频器件、高带宽存储（HBM）需求稳步增长；消费电子领域逐步复苏，中低端分立器件需求趋于稳定；工业自动化领域，智能电网、工业机器人、工业控制模块等场景，推动高可靠性、高精度分立器件的需求持续攀升。

②技术升级趋势明确：小型化与集成化持续深化，SOT、QFN 等微型封装技术广泛应用，SiP（系统级封装）技术逐步普及，器件集成度与核心性能持续提升；材料创新成为企业核心竞争力，SiC 和 GaN 器件在新能源汽车、数据中心、储能等领域的渗透率快速提升，2025 年全球 SiC 功率器件市场规模达 320 亿美元，同比增长 18.5%；绿色制造成为行业硬性要求，环保政策持续趋严，行业内企业纷纷优化生产工艺，推进无铅封装、废水回收、余热利用等绿色生产模式，降低能耗与污染物排放，践行可持续发展理念。

③市场格局逐步优化：区域分布持续集中，中国半导体分立器件产能主要集中于长三角、珠三角地区，其中江苏省产业链布局进一步完善，已形成涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试的完整产业链集群；国际竞争方面，海外厂商仍占据高端市场主导地位，但国内企业凭借高性价比优势、本土化服务能力和核心技术突破，持续抢占中高端市场份额，产品出口规模稳步扩大，逐步参与全球市场竞争，国际影响力持续提升。

## （3）行业的主要技术门槛

设计与制造工艺门槛持续提升，2025 年高端分立器件（如高压 IGBT、高频 GaN 器件、车规级 SiC MOSFET）对芯片设计、晶圆制造、先进封装等核心技术的要求进一步提高，对高精度生产设备的依赖度依然较高，国内企业在高端生产设备自主化方面仍需突破关键瓶颈；

材料研发壁垒显著，SiC 衬底制备良率虽较 2024 年有所提升，但整体仍处于较低水平，GaN 外延层质量控制难度较大，需企业长期投入技术研发与经验积累；

供应链与成本控制难度依然较大，全球地缘政治冲突仍有反复，核心原材料价格波动明显，企业需持续完善多元化供应链体系，提升成本控制能力；

研发投入要求持续提高，行业头部企业年研发费用占比维持在 10%以上，中小企业面临较大的资金与技术压力；

应用适配能力要求提升，下游客户（如车企、储能企业）对器件的定制化、高可靠性需求日益增加，要求供应商具备快速响应与联合开发能力；

环保合规成本持续上升，各国环保政策日趋严格，企业需持续投入环保设施建设，优化生产工艺，确保满足环保合规要求。

## （4）行业展望与挑战

行业发展机遇主要体现在：国家“十四五”半导体产业专项持续推进，政策支持力度不减，

为行业发展提供良好政策环境；新能源汽车、储能、5G、AI 等新兴领域需求持续爆发，为行业提供广阔市场空间；国产替代进程持续深化，国内企业迎来前所未有的发展机遇；产学研协同创新加速推进，核心技术突破速度持续提升。

行业面临的主要风险包括：全球经济复苏不及预期，可能导致下游市场需求收缩；国际贸易摩擦持续，影响芯片、高端设备等核心资源的稳定供应；技术迭代速度加快，可能导致现有产能面临淘汰风险；行业竞争加剧，部分领域价格战可能压缩企业利润空间。

## (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### (1) 行业地位现状

公司作为国内半导体分立器件领域的核心参与者，持续深耕半导体分立器件的研发、生产与销售业务，产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、工业控制、储能等多个核心领域。经过多年行业深耕积淀，尤其是 2025 年在核心技术突破与产能规模扩张方面的显著成效，公司在多门类系列化器件设计、芯片设计、部分品种芯片制造、封装设计、多工艺封装测试等核心环节的技术优势进一步巩固，具备较强的根据客户需求进行产品定制，并通过多工艺制造平台提供专业化生产服务的能力，已成为国内具备较强综合竞争力的半导体分立器件生产厂商。

公司作为国家级专精特新小巨人企业，在半导体分立器件细分市场的影响力持续提升；依托国家级“绿色工厂”资质，持续推进绿色生产模式，契合全球绿色供应链发展趋势，品牌形象进一步升级。2025 年，公司在中低端功率器件（如 MOSFET、IGBT）市场的进口替代率持续提升，稳步向高端领域渗透；小信号器件作为公司的核心优势产品，凭借齐全的封装形式、丰富的产品门类、稳定的产品品质，持续保持绝对先发优势，仍是该细分领域的知名品牌；同时，公司在车规级器件、第三代半导体 SiC 领域的市场地位快速提升，已成为国内车规级中大功率的核心供应商之一。

### (2) 行业地位变化趋势

2025 年在中美科技博弈持续、国内本土供应链自主可控需求日益迫切的行业背景下，国内下游客户对本土半导体供应商的依赖度持续提升，公司在新能源汽车、消费电子、工业控制、储能等领域的客户基础进一步巩固。目前，公司在计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制、储能等领域已获得诸多知名龙头客户的长期认可，随着公司技术水平的不断提升，产品逐步进入高端工业控制、安防设备、高端汽车电子、医疗器械等高端应用领域，客户认证优势持续扩大。

公司作为国内半导体分立器件领域首家加入国际汽车电子技术委员会的企业，在汽车电子相关领域的先发优势进一步凸显，2025 年车规级产品成功获得更多车企供应链认证，市场份额持续提升。近年来，尤其是 2025 年，公司在车规级功率器件、第三代半导体器件方面的大力投入取得显著成效，在车载领域的市场影响力持续扩大，尤其在中大功率 MOSFET 领域，已成为国内半导体分立器件行业中规模较大的领先企业，2025 年车载领域销售占比较 2024 年实现显著增幅；同时，随着 SiC MOSFET 技术的持续突破和产业化落地进程加快，公司在第三代半导体领域的行业地位将进一步提升，逐步发展成为国内第三代半导体分立器件领域的核心参与者。

## (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025 年半导体行业作为信息技术产业的核心基石，在全球科技变革的浪潮中持续发挥核心支撑作用，不仅支撑计算机、通信、消费电子等传统领域的持续升级，更深度赋能新能源汽车、储能、AI、物联网等新兴领域的快速发展。根据中研普华产业研究院发布的《2025-2030 年半导体产业深度调研及未来发展趋势预测报告》分析，2025 年全球半导体市场规模实现稳步增长，达到 6971

亿美元，同比增长 11.0%，与年初预期持平，核心增长动力来自新能源汽车、储能、工业自动化以及人工智能等领域的强劲需求；预计 2026 年全球半导体市场规模将突破 7700 亿美元，同比增长 10.5%，行业将正式进入持续稳健增长周期。

2025 年度半导体行业新技术、新产业、新业态、新模式呈现显著发展态势，主要体现在以下四个方面：

(1) 技术不断升级与创新，核心领域突破加速。

2025 年，半导体行业持续向更先进制程技术和新型半导体材料方向迭代，主流制程技术逐步向 2nm、1nm 推进，台积电、三星、英特尔等国际巨头纷纷加大先进制程工艺布局，着力提升芯片性能、降低功耗；同时，碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等第三代半导体材料的技术日趋成熟，应用场景持续拓展，公司与复旦大学开展产学研深度合作，在新能源汽车用 SiC MOSFET 关键技术研发方面取得阶段性重要进展，共同突破三大核心技术领域，申请 1 项发明专利并获授权，发表 2 篇核心期刊论文，参与第三代半导体产业技术创新联盟标准制定工作，助力国内第三代半导体技术自主发展。此外，Chiplet、SiP 等先进封装技术快速普及，成为提升芯片性能、降低生产成本的重要路径，行业内企业纷纷加大先进封装技术研发与投入力度。

(2) 产业链协同发展深化，自主可控能力提升。

2025 年，半导体产业链涵盖的芯片设计、晶圆制造、封装测试等多个环节的协同合作更加紧密，国内产业链上下游企业持续加强战略合作，通过原材料供应、制造代工、封装测试以及销售渠道等方面的整合与优化，有效降低生产成本，提升整体市场竞争力；同时，各国政府持续加大对半导体产业的支持力度，通过产业扶持政策、税收优惠、研发补贴等多种手段，推动产业链协同发展和核心环节自主可控，国内半导体产业链的完整性和抗风险韧性持续提升，本土供应链合作日益紧密。

(3) 国产化替代加速推进，国内企业崛起壮大。

2025 年，半导体市场需求持续增长，尤其是在新能源汽车、储能、工业自动化和消费电子等核心领域，随着全球经济逐步复苏，下游企业备货需求稳步上升，行业库存回归合理水平。同时，面对国际供应链的不确定性，半导体设备及器件的国产替代重要性日益凸显，在国家政策扶持与市场需求拉动的双重驱动下，国产替代进程持续加速，国内企业通过核心技术创新和产业升级，逐步替代进口产品，市场占有率持续提升，头部企业逐步参与全球市场竞争，产品出口规模稳步扩大。

(4) 下游应用领域持续深化，新兴场景快速拓展。

半导体在计算机、通信、消费电子等传统应用领域继续发挥重要支撑作用，随着数字化转型加速和智能化趋势推进，这些领域对高性能、低功耗芯片的需求持续增加，半导体企业纷纷推出针对性新产品以满足市场需求；同时，半导体在新能源汽车、储能、物联网、人工智能、自动驾驶等新兴应用领域的应用场景持续拓展，展现出巨大发展潜力，其中储能领域成为新的增长热点，带动高压、高功率器件需求快速增长；自动驾驶技术逐步向 L3 及以上级别推进，推动自动驾驶芯片、车规级分立器件的需求持续提升，这些新兴应用领域为半导体行业提供了广阔的增长空间。

未来（2026-2030 年），半导体行业将进入持续稳健增长的高质量发展阶段，核心发展趋势主要体现在四个方面：一是技术创新持续深化，第三代半导体材料（SiC、GaN）、先进封装技术（Chiplet、SiP）将成为行业技术创新的核心方向，技术迭代速度持续加快；二是产业链协同进一步加强，国内半导体产业链将逐步实现核心环节自主可控，本土企业的全球竞争力持续提升；三是国产替代持续推进，高端领域进口替代将成为行业发展核心主线，国内企业将逐步占据中高端市场主导地位；四是绿色环保与可持续发展成为行业共识，绿色生产、低碳制造将成为企业核心竞争力之一，ESG 理念将深度融入企业发展全过程。半导体行业将持续赋能全球科技产业的繁荣发展，成为推动数字经济高质量发展的核心引擎。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	2,333,731,537.60	2,205,810,186.87	5.80	1,990,282,900.28
归属于上市公司股东的净资产	1,379,474,478.72	1,326,873,054.83	3.96	1,317,708,884.61
营业收入	1,049,562,546.87	909,049,584.47	15.46	695,265,111.22
利润总额	78,197,905.99	74,574,364.25	4.86	68,873,497.75
归属于上市公司股东的净利润	79,904,688.58	71,874,234.87	11.17	64,052,300.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,165,932.14	48,049,884.64	27.30	32,202,494.99
经营活动产生的现金流量净额	43,750,066.83	67,025,363.87	-34.73	101,657,078.77
加权平均净资产收益率(%)	5.92	5.47	增加0.45个百分点	4.94
基本每股收益(元/股)	0.63	0.56	12.50	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.56	12.50	0.50
研发投入占营业收入的比例(%)	5.88	6.17	减少0.29个百分点	6.06

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	218,412,648.12	258,190,485.18	268,194,052.78	304,765,360.79
归属于上市公司股东的净利润	6,100,171.29	21,120,899.76	19,070,984.03	33,612,633.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	961,136.35	16,724,813.51	15,679,572.69	27,800,409.59
经营活动产生的现金流量净额	4,174,234.60	14,355,672.48	8,369,296.21	16,850,863.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4、股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							7,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							8,502
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
常州银河星源投资有限公司	0	40,747,740	31.61	0	无		境内非 国有法 人
ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED	0	34,473,000	26.74	0	无		境外法 人
常州银江投资管理中 心(有限合伙)	-2,692,391	5,489,869	4.26	0	无		其他
常州银冠投资管理中 心(有限合伙)	-2,415,062	3,092,938	2.40	0	无		其他

邢成	633,807	1,089,843	0.85	0	无	境内自然人
陈峰	698,833	698,833	0.54	0	无	境内自然人
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	504,057	610,463	0.47	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	41,852	605,317	0.47	0	无	其他
梁润权	411,384	523,268	0.41	0	无	境内自然人
高盛国际—自有资金	388,814	477,170	0.37	0	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，常州银河星源投资有限公司持有公司 31.61%的股权，为公司的控股股东；杨森茂先生通过常州银河星源投资有限公司、恒星国际有限公司（ACTION STARINTERNATIONAL LIMITED）、常州银江投资管理中心（有限合伙）与常州银冠投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 65.01%的股权，为公司的实际控制人。除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

## 存托凭证持有人情况

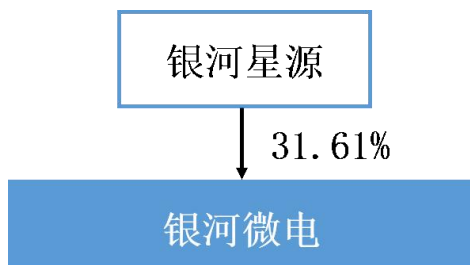
□适用 √不适用

## 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

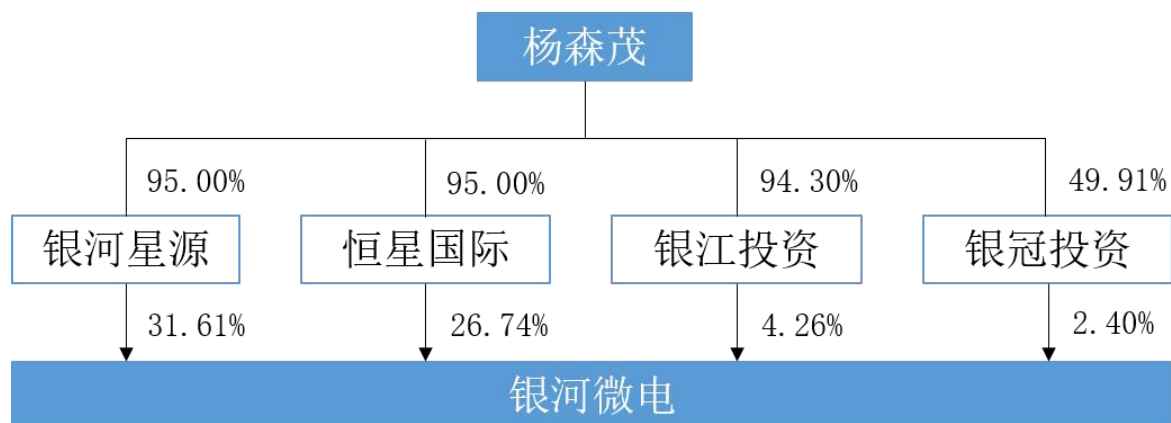
## 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

#### 5、公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年公司实现营业收入104,956.25万元，同比增加15.46%；实现归属于母公司所有者的净利润7,990.47万元，同比增加11.17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,116.59万元，同比增加27.30%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用